****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.es](http://www.congatec.es) | [info@sams-network.com](mailto:info@prismapr.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*congatec proporciona un soporte completo de las nuevas especificaciones de los módulos COM Express 3.0, 2.1 y Qseven 2.0*

*Texto y foto también disponible online en::* [*http://www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

Nota de prensa

**congatec presenta la hoja de ruta para SMARC 2.0, Qseven 2.1 y COM Express 3.0**

**congatec es totalmente compatible con las próximas especificaciones COM (Computer-on-Module) SGET y PICMG**

**Deggendorf, Alemania 23 de febrero de 2016 \* \* \*** congatec, una compañía de tecnología líder para módulos informáticos integrados, ordenadores monoplaca (SBC) y servicios de fabricación y diseño embebido (EDM), anunció en el Embedded World que es totalmente compatible con las próximas especificaciones COM (Computer-on-Module) SGET y PICMG, SMARC 2.0, Qseven 2.1 y y COM Express 3.0. Módulos que cumplan con estas normas ya están en desarrollo y se anunciarán próximamente, con el lanzamiento de las generaciones de procesadores.

**Hoja de ruta para SMARC y Qseven**

congatec soportará totalmente la especificación SMARC 2.0. Los módulos SMARC 2.0 estarán disponibles para toda la gama de tecnologías de procesadores relevantes - desde el procesador Intel® Atom ™ a varios diseños de ARM.

congatec continúa soportando todos los procesadores de bajo consumo de corriente también para diseños Qseven 2.1.

La diferencia esencial entre las dos normas es el número de interfaces compatibles con Qseven que proporciona hasta 230, y SMARC 2,0 hasta 314 pines. SMARC pretende interconectar los sistemas más ricos con los tamaños más reducidos; mientras Qseven es ideal para diseños de módulos más finos y menos complejos y diseños de placas portadoras.

congatec ha jugado un papel importante y activo en el desarrollo de todos los estándares. Para las especificaciones Qseven y SMARC congatec incluso ha asumido el papel de editor, y es por lo tanto un proveedor de tecnología clave para diseños SFF muy compactos basados en módulos COM, un mercado donde congatec se ha establecido como líder de la industria.

Christian Eder, Director de marketing en congatec, miembro de la junta SGET y editor de especificaciones SMARC comenta, "Al tomar el gran paso desde SMARC 1.1 a 2.0, hemos logrado dar a esta norma una perspectiva clara para el futuro. Este gran salto ha traído nuevas interfaces y se elimina una gran cantidad de características obsoletas. Aunque los diseños basados en 1.1 ya no puede ser compatibles con 2.0, los usuarios son compensados ​​por numerosas características nuevas".

**La hoja de ruta de COM Express**

COM Express 3.0 ofrecerá principalmente un nuevo tipo de pinout, específico para módulos COM. Los procesadores Intel® Xeon® e Intel Core™ enfocados a servidores, así como los procesadores de la serie R de AMD Embedded son los principales objetivos, con plataformas basadas en ARM otra opción posible.

"Todas las nuevas especificaciones proporcionan a los desarrolladores soporte para las últimas interfaces y muchos detalles mejorados. Junto a la nueva SMARC 2.0 para los sistemas multifunción altamente compactos, la nueva asignación de pines de COM Express para módulos servidor (SOM), es particularmente innovadora. Nos permite dirigirnos a los nuevos mercados para servidores punteros descentralizados en tiempo real, que se utilizan en la transmisión de medios, así como las aplicaciones de IoT, M2M, médicas y de automatización ", explica Martin Danzer, Director de producto en congatec.

Con el servicio de integración personal de congatec, los desarrolladores encontrarán fácil de integrar las nuevas revisiones en futuros diseños de sistemas. Como la mayoría de las características son compatibles con versiones anteriores, es posible, en muchos casos, actualizar tarjetas portadoras existentes con nuevos módulos. Esto proporciona protección de la inversión para los fabricantes de equipos originales (OEMs) para los diseños de sistemas existentes.

**Acerca de congatec AG**congatec AG, con sede central en Deggendorf (Alemania), es un proveedor líder de módulos informáticos industriales basados en los factores de forma estándar Qseven, COM Express, XTX y ETX, así como de ordenadores de placa única y servicios EDM. Los productos de esta empresa ofrecen múltiples aplicaciones y se utilizan, por ejemplo, en las áreas de automatización industrial, tecnología médica, suministros para el sector del automóvil, aeronáutica y transporte. Los conocimientos básicos y técnicos incluyen funcionalidades BIOS extendidas de características únicas, junto con amplios paquetes de soporte de placa y controladores. A partir de la fase de diseño, los clientes reciben un apoyo adecuado a través de una gestión integral del ciclo de vida del producto. Los productos son fabricados por proveedores especializados de acuerdo con las más modernas normas de calidad. En la actualidad congatec cuenta con 177 empleados y con establecimientos situados en Taiwán, Japón, China, Estados Unidos, Australia y la República Checa. Para obtener más información, consulte en [www.congatec.com](http://www.congatec.com/h) o a través de [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec/h), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG/h) y [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE/h).

\* \* \*